

製品データシート

WS3600
インターコネクト用フラックス

利点

- ・微細ボールサイズ用向きの優れたレオロジー特性
- ・均一なピン転写
- ・BGA パンプ形成工程で高い歩留まりを提供
- ・優れたはんだめれ性
- ・加工条件範囲が広く Sn/Pb、Pb フリー、および鉛高含有の各種用途向き

概要

WS3600 インターコネクト用フラックスは、BGA パンプ形成や基板レベルの接合用に設計された、低粘度のペースト状フラックスです。本品は赤く着色されており、それが自動検出装置の使用や目視検査に役立ちます。

特性

フラックス・タイプ 分類	HL
色	赤色
ステンシル寿命	室温で >8 時間
製品寿命	-20°C ~ +5°C 環境で 6 カ月
SIR (ohms、洗浄後)	合格 (>10 ⁶ 、7 日後 85°C & 85% RH 環境下)
標準粘度 コーンプレート型	16 kcps、5rpm 時
ハロゲン化物含有率	<3.5% Cl 等価
酸性度指数:	70-85
粘着力:	150-400g

情報はすべて参考のためのみのものです。今後出される製品の仕様として使用するものではありません。

パッケージング

WS3600 は、各種サイズの SEMCO カートリッジ、100g 広口ビン、または 10~150g シリンジ入りとなっています。ご要望に応じ他のパッケージング形態でも提供可能です。

洗浄

室温ないしはそれ以上の温度の純水または水に洗浄剤を加えた溶液を使用し、>1 分間、>60psi の圧力で洗浄します。



リフロー

大気または窒素雰囲気でのピーク・リフロー温度は、<350°C で、固相線より 30°C 上まで直線的に温度上昇させます。

保管

WS3600 シリンジおよびカートリッジは、チップ部を下に向け 0°C ~ 25°C の環境で保管します。**WS3600** は、使用する前に 4 時間室温に放置してください。

技術サポート

インジウム・コーポレーションでは、経験豊富なエンジニアが、お客様に対し詳細な技術支援を提供いたします。エレクトロニクスおよび半導体分野に関わる限りにおいて材料科学のあらゆる面に精通した技術サポート・エンジニアは、半田の特性、合金の相性、そして半田プリフォーム、ワイヤー、リボン、ペーストの選定などにおいて、専門的アドバイスをを行います。また、技術サポート・エンジニアは、すべての技術的問い合わせに対し迅速に回答致します。

材料安全データシート

本製品の材料安全データシート (MSDS) は、次の URL でご覧いただけます。<http://www.indium.com/techlibrary/msds.php>

ここに記載の情報は、一般情報としてのみ提供されるものであり、当該製品（販売時に製品パッケージおよびインボイスに記載される製品保証およびその仕様書に帰属した条件で販売されます）の性能を保証するものではありません。

びその仕様書に帰属した条件で販売されます）の性能を保証するわけではありません。

Form No. 98223(J A4) R0

半田

INDIUM CORPORATION®

www.indium.com
 asiapac@indium.com
 中華人民共和國: +86 (0)512 628 34900
 シンガポール: +65 6268 8678
 英国: +44 (0)1908 580400
 米国: +1 315 853 4900

ISO 9001
認証